

Panne de soudage burin 30° 0,8 mm micro fine série T - Thermaltronics TM70CH008

Réf. article WL38452

Fabricant Thermaltronics

Panne burin de 0,8 mm de face utile, la largeur la plus courante en soudage fin entre 0,6 et 1,5 mm. La surface transmet assez de chaleur pour les broches SOIC et les composants puces sans toucher les pastilles voisines. Cartouche série T pour SHP-T, 350-398 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Sur des cartes à pas mixtes, 0,8 mm est la largeur de burin la plus pratique pour la majorité des soudures fines. La TM70CH008 la propose en cartouche micro fine de la série T Thermaltronics, avec 13 mm de longueur de panne et une plage réglée de 350-398 °C.

AVANTAGES

- Largeur de burin 0,8 mm (0,03 in), la taille la plus employée en soudage fin
- Exécution micro fine avec face de contact définie pour un mouillage régulier
- Longueur de panne 13 mm pour l'accès sur cartes peuplées
- Technologie à point de Curie, 350-398 °C sans étalonnage
- Conforme RoHS et prévue pour les alliages sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38452
Modèle	TM70CH008
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM70CH008
Série	Série de pannes T, 350-398 °C
Plage de température	350-398 °C

Panne de soudage ou de dessoudage	Panne de soudage
Forme de panne	Burin, micro fine
Largeur de panne	0,8 mm (0,03 in)
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Pose et reprise de boîtiers SOIC et SOT, soudage de résistances et de condensateurs puces, raccordement de fils fins et travaux de réparation courants sur ensembles électroniques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

À utiliser avec la pièce à main SHP-T sur les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une cartouche de soudage est incluse.